

证券简称：博敏电子

证券代码：603936

## 博敏电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

| <b>投资者关系活动类别</b>     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  |                            |   |      |      |    |                        |                            |   |
|----------------------|--|----------------------------|---|------|------|----|------------------------|----------------------------|---|
| <b>参与单位名称及人员姓名</b>   | 招商证券张益敏、兴证全球基金厉之千、睿远基金孙瑶月、汇添富基金徐逸舟、睿郡资产刘国星   |                            |   |      |      |    |                        |                            |   |
| <b>时间</b>            | 2022 年 1 月 5 日，16:00-17:30   |                            |   |      |      |    |                        |                            |   |
| <b>地点</b>            | 博敏电子股份有限公司会议室  |                            |   |      |      |    |                        |                            |   |
| <b>上市公司接待人员姓名</b>    | 财务总监刘远程、董事会秘书黄晓丹、副总经理/微芯事业部执行总经理王强   |                            |   |      |      |    |                        |                            |   |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> | <p><b>第一个环节 公司基本情况介绍</b></p> <p>董事会秘书从公司的发展历程、行业地位、战略聚焦和升级、前三季度经营业绩、PCB 和 PCBA 两大事业群的业务发展情况及未来规划等方面进行了介绍。</p> <p><b>第二个环节 交流环节</b></p> <p>Q1：各工厂的产品和产能节奏能否详细介绍一下？梅州和江苏项目扩产的情况能否也介绍一下？</p> <p>A1：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工厂</th> <th style="width: 15%;">产能</th> <th style="width: 35%;">产品类别</th> <th style="width: 35%;">扩产计划</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">梅州</td> <td style="text-align: center;">15.2 m<sup>2</sup>/月</td> <td style="text-align: center;">以多层板和 HDI 为主，<br/>一条 R&amp;F 专线</td> <td>总投资 30 亿，正式动工之日起计三年内实现首期投产、五年内实现全部建成投产，年产量 360 万平方米。项目已</td> </tr> </tbody> </table> | 工厂                         | 产能  | 产品类别 | 扩产计划 | 梅州 | 15.2 m <sup>2</sup> /月 | 以多层板和 HDI 为主，<br>一条 R&F 专线 | 总投资 30 亿，正式动工之日起计三年内实现首期投产、五年内实现全部建成投产，年产量 360 万平方米。项目已 |
| 工厂                   | 产能   | 产品类别                       | 扩产计划  |      |      |    |                        |                            |   |
| 梅州                   | 15.2 m <sup>2</sup> /月   | 以多层板和 HDI 为主，<br>一条 R&F 专线 | 总投资 30 亿，正式动工之日起计三年内实现首期投产、五年内实现全部建成投产，年产量 360 万平方米。项目已 |      |      |    |                        |                            |   |

|    |                          |                        |  |
|----|--------------------------|------------------------|--|
|    |                          |                        | 于上月奠基，目前处于“三通一平”阶段，预计 2024 年起陆续释放部分产能。   |
| 深圳 | 2.8 万 m <sup>2</sup> / 月 | 以新能源汽车、军工、高频高速板、特种板等为主 | /  |
| 江苏 | 4 万 m <sup>2</sup> / 月   | 以手机模块和 HDI 为主          | 总投资 20 亿，已在 2020 年开工建设，去年封顶，预计 2022 年 7 月达产，2023 年下半年全面达产后将新增年产 HDI 板 72 万平方米，软硬结合板 12 万平方米。 |

**Q2:** 请问公司高端 HDI 产品以多少阶为主，Anylayer 能做吗？主要客户有哪些？

**A2:** 公司生产的高端 HDI 产品主要以二、三阶为主，Anylayer 可以做，但是目前这块的客户需求不大。二、三阶 HDI 主要应用于手机、笔电、miniled 等领域，客户有华勤、三星、利亚德等。

**Q3:** 请介绍一下公司目前 IGBT 的技术及订单情况，未来市场空间的展望，未来产能爬坡情况预期如何？

**A3:** 微芯事业部的 IGBT 衬板目前已具备 8 万张/月的产能规模，后续设备也在不断投入中，预计三年内有望达到 20 万张/月的产能规模。

公司主打 AMB 技术路线，结合对钎料的研制能力、烧结研发技术以及多年印制电路板的制造经验等优势。在航天及轨道交通领域，通过对比国内几家头部供应商的产品，发现公司 IGBT 衬板在产品性能及性价比方面上拥有明显优势。

IGBT 陶瓷板项目在 2016 年开始研发，2018 年正式立项，2020 年正式形成产线规模，在研发阶段就与客户保持密接联系并进行相关产品验证工作，客户也积极参与到产品性能设计和可靠

性研究当中。目前和航天系列、轨道交通、工业电网、车规级四个维度的客户进行了合作，得到了客户在技术层面、性价比等方面的认可，作为器件国产化替代的中流砥柱。

该产线设备已于 2021 年全部到位并调试完成，目前客户推进速度较快，客户需求大于产能增速。

**Q4:** 5G 刚开始发展的期间，整个市场对 HDI 的需求还是很高的，后来因为贸易战原因，是否整个市场需求开始减弱？

**A4:** HDI 应用领域较为广泛，从手机、笔电、智能穿戴到新能源汽车等领域，所以并不会单纯因为手机市场或芯片的影响导致 HDI 需求的大幅下滑。

**Q5:** 目前公司产品的下游应用领域占比情况如何？

**A5:** 公司在深耕行业的同时不断向下游领域延伸，以此来满足客户日益增长的需求，所生产的产品主要应用于通讯设备（5G）、服务器、新能源汽车、消费电子、家电、航空航天等高科技领域。其中，占比最大的是智能终端 35%，包含手机 ODM 如华勤、立讯，三星笔电，歌尔 TWS 耳机等，数据/通讯 30%，汽车电子（含新能源三电）25%，miniled 及工控医疗等 10%。

**Q6:** 目前来看普通 PCB 的市场增速较慢，同行都纷纷在往 HDI 的方向进行扩产，会不会觉得市场竞争变得激烈，还是说整个市场需求增长较快，使得每家的产能都能得到消化？

**A6:** 公司从 2009 年开始涉足 HDI，在业内具备领先优势。HDI 符合未来整个终端市场发展的需要，随着电子产品向“短、小、精、薄”方向发展，它的需求会越来越大。从终端方面看，HDI 产品需求旺盛，从去年开始处于一个供不应求的阶段。后期随着大家扩产，还有终端市场一些其他因素的扰动，比如缺芯、贸易战等，短期内 HDI 的供需关系会出现一定的变化。考验的

是做 HDI 的企业如何抓住终端市场，如果是发展比较快的，企业恰好又有具体布局的，就能在后期取得竞争优势。像 miniled 是公司的特色产品，拥有利亚德等业内知名客户，如今 miniled 的机会已经到来，公司已跟相关客户探讨明年订单布局。如果终端市场这两年保持较快的发展势头，公司也将受益，所以好的布局很重要。

公司在 HDI 具备领先优势，在公司五年战略目标的指引下，加之几款特色产品的增量，已在细分领域保持了优势地位。随着这些市场需求的扩大，也能够带动 HDI 业务的扩展。

Q7: 江苏和梅州新增的产能具体情况？

A7: 江苏二期工厂预计今年开始陆续投产，预计扩 4 万平产能（3.5 万平 HDI/月+0.5 万平/月 IC 载板试验线）；梅州二期的产能没有那么快释放，预计到 2024 年才陆续出来，目前电声类产品需求量大，梅州目前 R&F 产能也是不够的，今年计划通过技改等手段扩 1 万平/月产能出来。总体来说基本保证每年 15%-20% 产能的有序扩张。

Q8: 布局 IC 载板的原因是什么？预计什么时候跑通？

A8: IC 载板属于试验线，是在 HDI 板的基础上发展而来，适应电子封装技术快速发展而向高端技术的延伸。国内芯片的发展，供应链爆发需求，公司具备相应的能力。但投资 IC 载板金额大、风险高、周期长，基于公司“PCB+核心元器件+解决方案”一体化战略，我们还是决定投资 IC 载板领域。后期随着新一轮融资资金到位，并结合 0.5 万平的验收情况，再进行 IC 载板的扩建。公司计划采取自建+合作方式，即与终端客户合作，产业联动，共同投资，共享资源。

Q9: IGBT 的团队是公司自己培养还是引进外部人才？

A9: 团队主要以公司培养为主，同时也从外部引进高端人才。

|    |  |
|----|--|
|    | <p><b>Q10: EDR 业务进展情况如何? 是否测算过 EDR 市场空间?</b></p> <p><b>A10:</b> 目前公司 EDR 业务处在为客户打样试产阶段, 因为是国家强制执行的, 需求量将会非常大, 我们已经做好了充分准备, 就看 edr 这些厂商如何导入整车厂, 目前他们正在做车规级的认证, 需要一定的周期。</p> <p><b>Q11: 三季度毛利率下降的原因是原材料涨价吗? 原材料涨价是否有做市场的传导? PCB 行业的拐点大概在什么时候?</b></p> <p><b>A11:</b> 主要是受原材料涨价影响, 前期内部虽然有通过技术改造、调整产品结构等措施来改善收入和毛利水平, 但受以铜为主的大宗商品涨价因素影响了部分毛利, 对双面、多层板影响较大, 后期部分化工类原材料涨价也影响了公司毛利。</p> <p>公司一方面与供应商建立长期战略合作关系, 与供应商共同研究降低成本的方案, 另一方面公司也积极向下游传导涨价, 但终究还是需要个过程。受国际环境和疫情等多重因素影响, 不好预判 PCB 行业的拐点, 但我们预判除化工商品外, 其他大宗商品的价格逐渐趋稳。</p> <p><b>Q12: 大股东未来是否会参与公司本次可转债认购?</b></p> <p><b>A12:</b> 大股东为支持公司发展, 届时会积极进行可转债认购, 但具体认购方案还未确定。</p> <p><b>Q13: 军工和储能业务情况? 军工毛利水平如何?</b></p> <p><b>A13:</b> 公司 2016 年已获得军工三证, 目前进行武器装备承制资格升级, 在无源器件、电子装联、强弱电一体化、高频高速等方面具备较好的技术优势, 取得客户的高度认可。军工的整体毛利水平相对比其他产品要好些。</p> |
| 日期 | 2022 年 1 月 6 日   |
| 备注 | 无  |